

会社名 株式会社サムコインターナショナル研究所

登録銘柄 (店頭登録銘柄)

コード番号 6387

本社所在都道府県 京都府

(URL <http://www.samco.co.jp>)

本社所在地 京都府京都市伏見区竹田藁屋町 36 番地

代表者 代表取締役社長 辻 理

問合せ先責任者 取締役管理本部長兼経理部長 山田史郎

中間決算取締役会開催日 平成 16 年 3 月 19 日

中間配当支払日 平成 - 年 - 月 - 日

T E L (075) 621 - 7841

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

1. 16 年 1 月中間期の業績 (平成 15 年 8 月 1 日 ~ 平成 16 年 1 月 31 日)

(1) 経営成績 (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 1 月中間期	1,690	(1.4)	200	(0.3)	175	(5.8)
15 年 1 月中間期	1,667	(9.3)	200	(46.5)	185	(49.6)
15 年 7 月期	3,435		416		395	

	中間(当期)純利益		1 株当たり中間 (当期)純利益	潜在株式調整後 1 株当 たり中間(当期)純利益
	百万円	%	円 銭	円 銭
16 年 1 月中間期	107	(4.0)	21 94	
15 年 1 月中間期	103	(46.1)	21 10	
15 年 7 月期	221		44 53	

(注) 1. 持分法投資損益 16 年 1 月中間期 百万円 15 年 1 月中間期 百万円 15 年 7 月期 百万円

2. 期中平均株式数 16 年 1 月中間期 4,889,140 株 15 年 1 月中間期 4,889,140 株 15 年 7 月期 4,889,140 株

3. 会計処理の方法の変更 無

4. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

5. 期中平均株式数及び期末発行済株式数は自己株式控除後のものです。

(2) 配当状況

	1 株当たり 中間配当金	1 株当たり 年間配当金
	円 銭	円 銭
16 年 1 月中間期	0 00	
15 年 1 月中間期	0 00	
15 年 7 月期		12 50

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16 年 1 月中間期	6,991	4,790	68.5	979 86
15 年 1 月中間期	7,264	4,628	63.7	946 68
15 年 7 月期	7,184	4,746	66.1	970 01

(注) 1. 期末発行済株式数 16 年 1 月中間期 4,889,140 株 15 年 1 月中間期 4,889,140 株 15 年 7 月期 4,889,140 株

2. 期末自己株式数 16 年 1 月中間期 1,750 株 15 年 1 月中間期 1,750 株 15 年 7 月期 1,750 株

(4) キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16 年 1 月中間期	254	12	235	1,240
15 年 1 月中間期	40	129	135	1,314
15 年 7 月期	88	154	308	1,244

2. 16 年 7 月期の業績予想 (平成 15 年 8 月 1 日 ~ 平成 16 年 7 月 31 日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金		
				中間	期末	
通 期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
	3,550	497	295	12 50	12 50	

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 59 円 11 銭

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる場合があります。なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、添付書類の 7 ページを参照してください。

添付書類

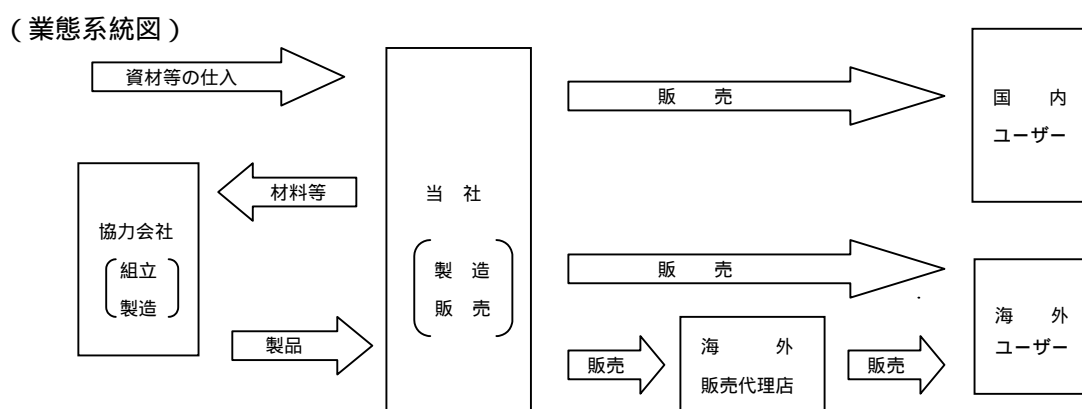
1. 企業集団の状況

当社は、単独で事業を営んでおり、関係会社はありません。

当社は、半導体等電子部品製造装置メーカーで、薄膜形成・加工装置の製造及び販売を事業としております。当社の基本となる薄膜形成技術はCVD法（Chemical Vapor Deposition = 化学的気相成長法）によるもので、当社の各装置においては、ナノテクノロジーと言われる10nm～100μmまでの成膜や加工が可能であります。（nm = ナノメートル：10億分の1メートル μm = マイクロメートル：1百万分の1メートル）

当社の装置は、薄膜を形成するCVD装置、薄膜を微細加工するエッチング装置、基板表面などをクリーニングする洗浄装置、その他装置等に区分されます。

当社の装置の製造に関しては、自社の設計企画により協力会社に製造を委託し、製品出荷の前に独自のプログラムソフトを入力し、仕様検査・出荷検査を経て販売しております。販売に関しては営業所を通じて行うとともに、海外については一部現地販売代理店に委託しており、これらの関係を図示すると以下の通りとなっております。



当社は装置等を以下の通りに区分しております。

(CVD装置)

反応性の気体を基板の上に堆積させる装置で、一般に減圧下で半導体の絶縁膜、光学薄膜などを形成するために使われます。特に当社は発火性のガスを使用しない液体原料を活用したLS-CVD装置（LS = Liquid Source）に特徴があり、比較的低温反応で成膜速度が速く、均一性の良い成膜が可能です。

(エッチング装置)

各種半導体の基板の膜をはじめ微細加工に必要な材料を切削加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて蝕刻していくものです。当社はICP（Inductive Coupled Plasma = 高密度プラズマ）を利用したエッチングに特徴があり、高速でかつ均一性の優れた加工が可能です。

(洗浄装置)

当社の装置は溶液を使用しないドライ洗浄方式で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて洗浄するところに特徴があります。高速で自動運転が可能であるため、高集積化を要求される3次元実装などに必要とされております。

(その他装置)

上記装置には含まれない特別な装置であります。

(その他)

部品、保守メンテナンスなどがあります。

2. 経営方針

(1) 経営の基本方針

当社は『薄膜技術で世界の産業科学に貢献する』ことを経営理念とし、社員の創造性を重視し、常に独創的な薄膜技術を世界の市場に送る。直販制度を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。事業が社会に果す役割を積極的に認識し、高い付加価値の追求を目標とし、株主、取引先、役員、従業員に対し、適切な成果の配分をする。を経営方針に掲げ、事業を展開しております。

(2) 利益配分に関する基本方針

当社は株主の皆様への利益還元を経営の重点政策として位置付けております。経営体質の強化と将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、安定配当を継続していくことを基本方針としております。

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針

当社は、当社株式の流動性の向上と株主数の増加を資本政策上の重要な課題と認識しております。特に1単元株式数の見直し等株式投資単位の引き下げにつきましては、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるために実行すべき課題として認識しております。今後の業績動向、市況の変化を十分に勘案しつつ、引き続き検討しタイミングを見て対処していく所存であります。

(4) 中期的な会社の経営戦略

当社は化合物半導体を中心としたオプトエレクトロニクス分野に経営資源を集中しながら、中期的には次の3点について戦略を展開してまいります。第一は、既に各種バックライトとして実用化の盛んなLED(Light Emitting Diode=発光ダイオード)や次世代大容量光ディスク用途向けに注目されているLD(Laser Diode=半導体レーザー)の量産化への対応及び各種センサーやチップが日々開発されて拡大している各種電子部品分野等への対応のため、本格的な量産用装置を開発し、メンテナンスを含めた販売力を強化していくこととあります。第二は、これらの分野も含めて、量産用と研究開発用が同時進行で拡大すると予想されている中国市場への積極展開であります。中国市場では既に商社と提携している一方、独自の販売事務所の設置を計画しております。第三は、CVD装置、エッチング装置、洗浄装置といった当社の三大製品群に匹敵するIT分野の第四の柱を確立することとあります。当社は、米国シリコンバレー、英国ケンブリッジとの3極体制で行っている研究開発と国内の大学や各種クラスターとの共同研究を行っておりますが、これらの中から、薄膜事業に関連する新事業、新分野をいち早く立ち上げ、当社の中期的な事業拡大に寄与する事業に成長させたいと考えております。

(5) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

当社では、効率的で健全な企業経営システムを構築する上で、コーポレート・ガバナンスの確立は極めて重要な経営課題であると認識しており、常に組織の見直しと諸制度の整備に取り組んでおります。株主総会は、設立時からの7月決算を貫くことにより、参加しやすく開かれた総会を目指しており、また取締役会は、意思決定の迅速化と経営責任を明確化するため、月1回以上の開催を定例化し、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項の決定を行うとともに、監査役の参加のもと、業務の執行状況を管理監督しております。当社の取締役は5名ですが、常に次世代を担う若手役員候補者を育成しながら、開かれた運営を基本としております。当社は監査役制度を採用しておりますが、監査役3名は全員社外監査役であり、取締役の職務執行の適法性と妥当性をチェックし、公正な意見が発言できる仕組みを作り上げております。内部統制については、社長室が年間計画に基づく業務監査を実施して、内部牽制の実効性を高めております。今後も、経営内容の透明性を高め各ステークホルダーから信頼される企業を目指して、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ってまいります。

(6) 対処すべき課題

現状の認識について

現在、デジタル家電関連を中心に旺盛な設備投資が続く中、LED、LDが牽引役となるオプトエレクトロニクス市場では、今後自動車関連部品や一般照明用に巨大市場の出現が予想されます。これまで当社装置の中心的用途となっていた研究開発用途に加え生産用途としての量産用装置の開発と販売・メンテナンス体制の確立を急ぐことが重要と考えております。また、これらの展開はグローバル化しており、特に中国市場は重点市場として早急に販売拠点を設立する必要があると認識しております。

当面の対処すべき課題の内容

当面の課題は上半期に投入致しました量産用 CVD 装置と独口バート・ボッシュ社より技術導入致しました「ボッシュプロセス」を取り入れた ICP ドライエッチング装置の販売力強化であります。また、オプトエレクトロニクス分野の LED、LD 用途向けの新型 MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition)装置の開発も重点的課題であります。そのためには、人材教育とともに、海外部門も含めた適材適所の人材を確保する必要があると考えております。

対処方針

量産用装置の販売力強化はスケジュール通り実行中ではありますが、適材適所の人材については、スキル保有人材を中心に各方面に広く門戸を開放し、中途採用を強化するとともに、独自の社内研修システムを確立していく方針であります。

具体的な取組み状況等

重点部門を絞った中途採用人材の募集のみならず、広く事業拡大に伴う業務提携についても先方の技術力等の評価と当社の業容との相乗効果を考慮しながら積極的に取組み、決定していく方針であります。

3. 経営成績及び財政状態

(1) 当中間期の概況

当中間期のわが国経済は、輸出を起点とした企業の生産活動が活発化し、旺盛なデジタル家電関連需要や株式市場の回復感から全面的な景気回復が期待される一方で、雇用情勢、所得環境の改善は依然力強さを欠く中で推移致しました。

当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましては、薄型 TV、デジタルカメラ、DVD レコーダーなどのデジタル家電関連を中心とした電子部品分野の設備投資が好調に推移したほか、オプトエレクトロニクス分野では、高輝度 LED が、各種バックライト・自動車関連部品・信号機用途として更に需要が拡大する展開となりました。

こうした環境の中、当社は、LED や LD などの光源用途とレンズ用途を柱とするオプトエレクトロニクス分野向けと、各種センサー用途やマイクロマシン用途を中心とする電子部品分野向けの販売が、CVD 装置、エッチング装置とともに堅調に推移するとともに、液晶に代わる次世代のディスプレイとして期待される有機 EL(Electro Luminescence)用途などの表示デバイス分野向けの販売も着実に実績を伸ばしました。特に海外向けでは、北米東海岸でナノテク関連用途を中心に MIT(マサチューセッツ工科大学)や現地メーカー数社からの受注が相次ぎ、欧米の装置メーカーと比較し当社装置の性能の高さが評価されました。製品開発では、各種デバイス材料として用途が拡大する化合物半導体分野向けに量産用 CVD 装置を開発し、微細化・高精度化が進展するマイクロマシン分野や電子部品分野向けに、独口パート・ボッシュ社よりの技術(ボッシュプロセス)導入でシリコンの高速ディープエッチング(深掘)装置を開発するなど成長分野に的を絞った積極的な研究開発活動を推進致しました。また、当社とキリンビール株式会社で共同開発したペットボトル内壁への炭素薄膜コーティング技術が、ライセンス供与されておりました三菱重工業株式会社によって実用化されることになりました。前期に引き続き、仕入原価や製造原価などのコスト削減に努めるとともに、販売価格の改定を実施致しました。

以上のような活動をしてまいりました結果、当中間期の売上高は 1,690,382 千円(前年同期比 1.4%増)と前年同期比微増となりましたが、生産用大型装置分野での実績づくりのための低価格受注と円高の進行による為替差損のため、経常利益は 175,070 千円(前年同期比 5.8%減)となりました。一方、中間純利益は、試験研究費の税額特別控除が適用される等あり 107,286 千円(前年同期比 4.0%増)となりました。

(CVD 装置)

オプトエレクトロニクス分野でデジタルカメラ等に搭載されるマイクロレンズ成型過程で使用される薄膜形成量産装置やマイクロマシンの研究開発用途向けの需要が回復致しました。また、3次元実装における層間絶縁膜の形成用途で当社の得意とする LS - CVD 装置が評価され、上半期の売上高は 463,355 千円(前年同期比 77.2%増)と大幅に増加致しました。下半期は、量産用途向けの出荷、有機 EL 等、FPD(Flat Panel Display)分野の封止膜用途での出荷が期待されます。

(エッチング装置)

集積回路用欠陥解析や電子部品加工用のエッチングで特に研究開発用として使い勝手が良い RIE - 10NR が根強い人気を受け海外向けの出荷も順調に伸びました。一方で、オプトエレクトロニクス分野の光源部門において、青色 LED の生産に不可欠な GaN(窒化ガリウム)のエッチング装置として ICP 型 RIE - 200iP の市場評価は定着したものの価格競争が激化致しました。その結果、上半期の売上高は 836,798 千円(前年同期比 24.3%減)となりました。

(洗浄装置)

従来の BGA(Ball Grid Array = 表面実装アレーの一種)基板の洗浄用途に加え青色 LED 実装前のクリーニング用途、有機 EL 等表示デバイスの表面処理用途で受注が好調で、上半期の売上高は 201,007 千円(前年同期比 65.3%増)となりました。

(その他装置)

当中間期の売上はありません。

(その他)

既存装置のメンテナンスや改造及び部品販売が出荷台数の増加に伴い比較的安定的に推移し、売上高は189,221千円(前年同期比26.6%増)の結果となりました。

(品目別売上高)

品目	売上高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
CVD装置	463,355	27.4	77.2
エッチング装置	836,798	49.5	24.3
洗浄装置	201,007	11.9	65.3
その他装置	-	-	-
その他	189,221	11.2	26.6
合計	1,690,382	100.0	1.4

なお、当社は装置により製造される半導体等電子部品をその用途により、LED・LD・DWDM(Dense Wavelength Division Multiplex = 高密度波長多重伝送)関連のオプトエレクトロニクス分野、各種センサー・磁気ヘッド・水晶デバイス・高周波デバイス等の電子部品分野、有機EL等の表示デバイス分野、半導体パッケージ技術や表面洗浄技術等の実装・表面処理分野、その他分野、部品・メンテナンスに分類しており、その売上構成は次の通りであります。

(用途別売上高)

用途	売上高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
オプトエレクトロニクス分野	567,832	33.6	32.0
電子部品分野	631,327	37.4	59.2
表示デバイス分野	132,175	7.8	38.5
実装・表面処理分野	125,249	7.4	132.3
その他分野	44,575	2.6	67.5
部品・メンテナンス	189,221	11.2	26.6
合計	1,690,382	100.0	1.4

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は税引前中間純利益が175,870千円(前年同期比4.6%減)となり、売上債権の減少額150,209千円がプラスに寄与したものの、借入金の返済173,951千円(うち短期借入金返済額100,951千円、長期借入金純減少額73,000千円)などにより、資金残高は前期末に比べ4,414千円減少し、当中間会計期間末には1,240,512千円(前年同期比5.6%減)となりました。また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は254,593千円(前年同期は使用した資金40,525千円)となりました。これは主に税引前中間純利益の175,870千円(前年同期比4.6%減)と売上債権の減少額150,209千円がプラスに寄与した一方、仕入債務の減少額が11,093千円にとどまるなどマイナス要因が小幅であったことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は12,894千円(前年同期比90.0%減)となりました。その主な内容は有形固定資産の取得による支出が6,653千円、定期預金の払戻による収入938,665千円に対して預入による支出が944,597千円であったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は235,066千円(前年同期比73.3%増)となりました。これは、短期借入金の減少額100,951千円、長期借入金の返済による支出123,000千円、長期借入金の借入による収入50,000千円と配当金の支払61,114千円によるものです。

(3) 通期の見通し

通期の見通しにつきましては、携帯電話やデジタル家電の需要拡大に伴う各種デバイスメーカーの設備投資を背景に、半導体レーザーやレンズ向けのオプトエレクトロニクス分野及び電子部品分野を中心に足元の受注状況が堅調に推移しているほか、FPD 分野において有機 EL 基板への封止膜形成用 CVD 装置を中心とした需要も拡大傾向にあります。また、当社のマザーマーケットである産官学のナノテク関連の研究開発分野での受注についても、政府の積極的な予算配分や景気の回復が追い風となって堅調に推移するものと見込んでおります。更には、競争力のある量産用新型機の投入を予定しており、利益率も改善することが予想されます。

以上の見通しですが、前述の新製品投入や新技術導入の収益効果が下半期後半から来期へずれ込むことから、通期の売上高は期初予想の 4,400 百万円から 3,550 百万円(前年同期比 3.3%増)へ、経常利益は 660 百万円から 497 百万円(前年同期比 25.8%増)、当期純利益は 355 百万円から 295 百万円(前年同期比 33.2%増)となる見込みであります。